

## 厦门优迅芯片股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2026-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026年5月15日(周五)下午 14:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事, 总经理柯腾隆 2、独立董事周剑扬 3、副总经理陈哲 4、副总经理刘伯坤 5、董事会秘书兼财务总监杨霞
投资者关系活动主要内容介绍	<b>投资者提出的问题及公司回复情况</b>  公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：  1、管理层您好。面对目前行业内较为激烈的市场竞争态势，公司在今年的市场开拓（例如渠道下沉、新客户拓展或海外市场布局）上，主要有哪些侧重点或新的规划思路？  尊敬的投资者，您好！公司基于“研发驱动、市场导向”战略，在激烈市场竞争中聚焦三大业务赛道的协同发展，市场开拓的侧重点，具体如下：  1. 深化电信市场布局：公司持续深耕无源光网络（PON）与光纤到房间（FTTR）领域，借助国内运营商千兆宽带升级机遇，强化渠道下沉与客户黏性。  2. 拓展高端数据中心客户：在数据中心侧，公司推进高速率电芯

片的技术突破与客户导入，重点布局 400G/800G 光模块应用的单波 100G 系列产品，并积极开发 1.6T 光模块的单波 200G 产品。同时，深化与头部客户联合研发，推动 LPO/NPO 等新架构落地，以拓展数通领域增量市场。

3. 延伸终端新兴应用领域：公司依托核心技术，战略延伸至高增长赛道如车载光通信、激光雷达及智能传感。其中，车载光通信产品已实现量产突破，并切入自动驾驶等新兴场景，逐步构建差异化竞争优势。

后续进展将严格遵循信息披露规定及时公告。感谢您对公司的关注！

## 2、请问 电芯片未来发展趋势如何

尊敬的投资者，您好！光通信电芯片领域正呈现以下核心方向：

一、高速率升级：随着 AI 算力、数据中心建设需求增长，光通信电芯片单波速率正向 100G/200G 快速升级，支撑 800G/1.6T 光模块规模部署。公司已布局单波 100G 电芯片工程片流片，并推进单波 200G 产品测试，以匹配高速光模块需求。

二、架构革新：架构向 LPO/NPO/CPO 演进，电光共封装显著降低功耗、提升带宽密度。公司正与头部厂商联合开发适配方案，优化芯片线性度及能效表现。

三、硅光集成规模化：硅光技术凭借高集成度、低成本优势成为高端光模块主流方案。公司深化硅光电芯片协同设计，提供完整解决方案，助力提升模块性能。

四、国产替代深化：高速核心芯片国产替代提速，25G 以上市场份额逐步提升，公司正加速突破 100G/200G 等高端产品，填补市场空白。

整体朝着高速率、低功耗、高集成、自主可控方向演进，支撑 6G 与 AI 智算网络建设。

公司将持续强化技术研发，把握行业扩容机遇，巩固在光通信电芯片领域的竞争优势。



全景  
资本市场服务平台

	感谢您对公司的关注！
附件清单(如有)	
日期	2026-05-15